



Конференция IPC
г. Москва, 3 и 4 сентября 2014 года
 Гостиничный комплекс «Измайлово Бета»
 Измайловское шоссе, д. 71, корп. 26

Компания «Диполь» приглашает специалистов электронной отрасли принять участие в конференции Ассоциации IPC — ведущей мировой организации, занимающейся стандартизацией в области производства электроники.

Впервые конференция IPC состоится в России. Соорганизатор конференции — официальный дистрибьютор стандартов IPC в России компания «Диполь». Программа мероприятия разработана подобно международным конференциям IPC и учитывает специфику российских технологий. В числе докладчиков: независимый эксперт Боб Уиллис, представитель IPC в Европе Ларс Валлин, мастер-тренер IPC Хан Раетсен. Помощь в проведении докладов и квалифицированный перевод — представитель IPC в России Юрий Ковалевский и сертифицированный тренер IPC Андрей Фешко («Диполь»).

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Программа первого дня

3 сентября мастер-классы № 1 и №2, а также № 3 и № 4 будут проводиться одновременно в разных аудиториях.

08:30–09:00	Регистрация	
09:00–09:15	Приветствие, представление участников и вступительное слово	
09:15–12:00 с перерывом на кофе-брейк	Мастер-класс № 1 Требования к производству ответственной электроники 3-го класса по IPC для всех звеньев производственной цепочки. <i>(Ларс Валлин)</i>	Мастер-класс № 2 Обсуждение технологий отмывки и конформных покрытий, 3-й класс IPC. <i>(Боб Уиллис)</i>
12:00–13:30	Обед	
13:30–16:30 с перерывом на кофе-брейк	Мастер-класс № 3 Устранение дефектов. Почему мои паяные соединения не идеальны? <i>(Ларс Валлин)</i>	Мастер-класс № 4 Практический анализ дефектов. <i>(Боб Уиллис)</i>
16:30	Обсуждение и завершение мастер-классов	

Программа второго дня

08:30–09:00	Регистрация
09:00–09:15	Приветствие, представление участников и вступительное слово. <i>(Юрий Ковалевский)</i>
09:15–10:30	Сборка с применением технологии Package On Package («корпус-на-корпус»), проектирование и управление процессом сборки. <i>(Боб Уиллис)</i>
10:30–11:00	Кофе-брейк
11:00–12:00	Современные материалы для сборки электроники. Свойства, особенности и методы контроля. <i>(Хан Раетсен)</i>
12:00–13:00	Обед
13:00–13:30	Контроль качества конформных покрытий, причины дефектов и методы устранения <i>(Боб Уиллис)</i>
13:30–14:00	Определение наиболее важных параметров при выборе финишных покрытий для плат и компонентов IPC-4552, 4553 и 4554. <i>(Боб Уиллис)</i>
14:00–14:30	Особенности применения смешанной технологии: свинецсодержащие и бессвинцовые материалы и компоненты. <i>(Хан Раетсен)</i>
14:30–15:00	Кофе-брейк.
15:00–15:45	Практические советы: как использовать стандарты IPC во всей производственной цепочке с применением чек-листа IPC. <i>(Ларс Валлин)</i> <i>Копия чек-листа будет предоставлена всем участникам.</i>
15:45–16:30	Вопросы и ответы
16:30	Обсуждение и завершение конференции.

